

关键指标

频率: DC~20GHz
 插入损耗: 1.2dB
 隔离度: 50dB
 电压/电流: -5V/1mA
 控制电平: 0, 3.3V~5V
 芯片尺寸: 1.25mm×0.95mm

产品简介

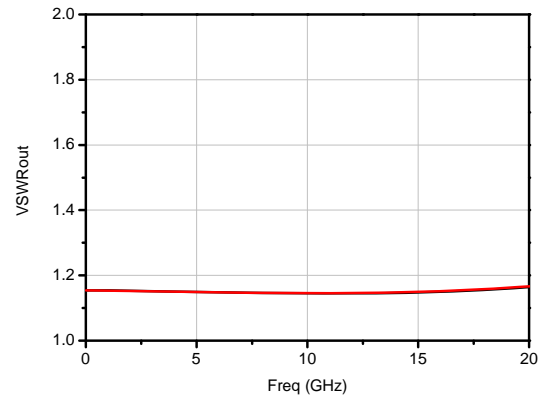
HG127KC 是一款 DC~20GHz 吸收式单刀双掷开关芯片, 插入损耗为 1.2dB, 隔离度为 50dB。集成驱动控制器。

电性能 (TA=25°C, VEE=-5V)

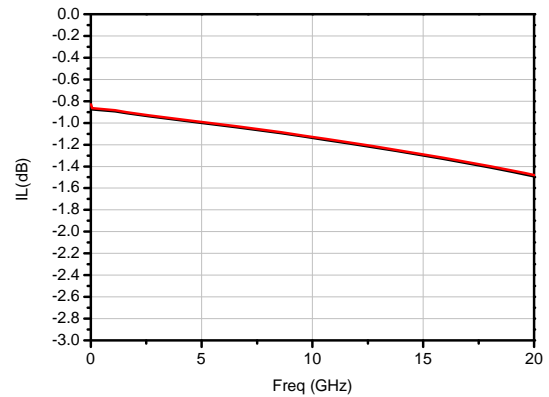
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~20		
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.2	-
插入损耗(dB)	-	1.2	-
隔离度(dB)	-	50	-
静态电流 (mA)	-	1	-

典型测试曲线

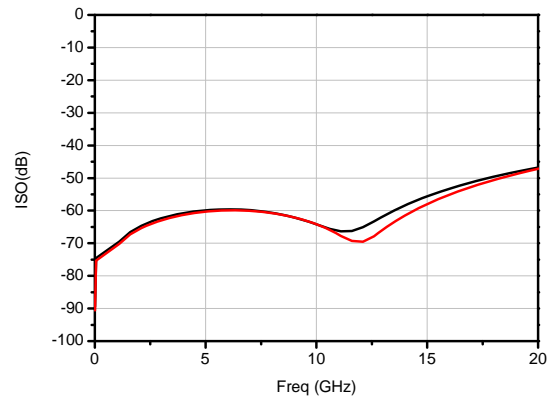
输出驻波 (关断态)



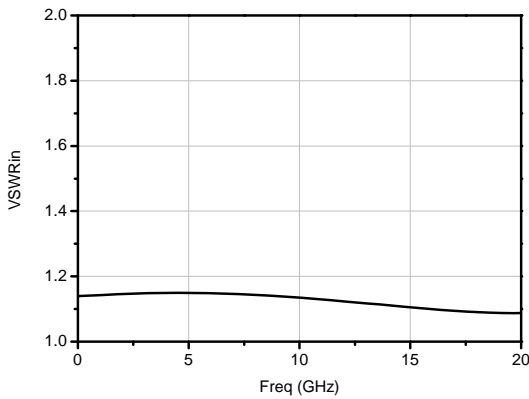
插入损耗



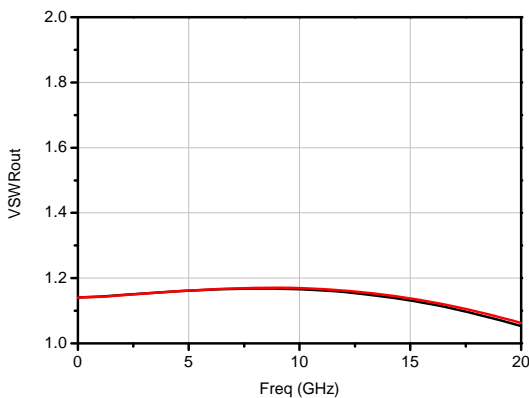
隔离度



输入驻波



输出驻波(导通态)



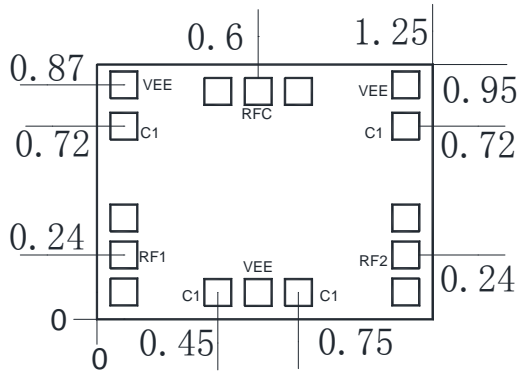
开关真值表

VEE	C1	RFC-RF1	RFC-RF2
-5V	0V	ON	OFF
-5V	5V	OFF	ON

绝对额定最大值

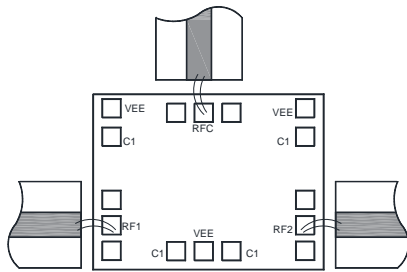
最大输入功率	+27dBm	
工作电压	-5.5V	
控制电压	低电平: 0~0.5V	高电平: 3~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图

注： VEE 加电端与 C1 控制端口各任选 1 个即可。



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。